

低温実装と鉛フリー高温はんだ代替に利用

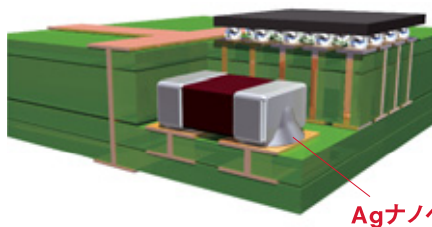
Used for low-temperature mounting and as a lead-free alternative to high-temperature solder

特長

- 200~250℃の低温で実装可能、耐熱温度の低い太陽光セル実装に最適。
- 動作温度が高いパワーモジュールやLED実装に最適。
- 微細化で150~160℃実装に期待。低温加熱でオーミックなコンタクトを可能に。

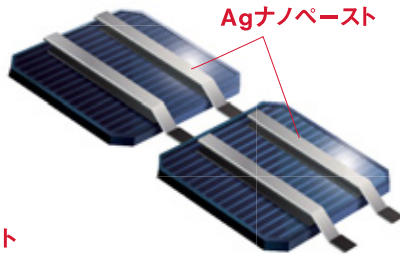
用途

□ 3D実装の内部接続用として



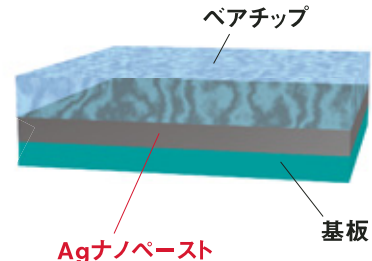
Agナノペースト

□ 太陽光セル実装用に



Agナノペースト

□ デバイスのダイボンディングに



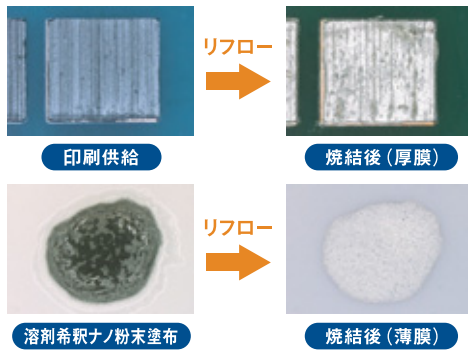
Agナノペースト

ベアチップ

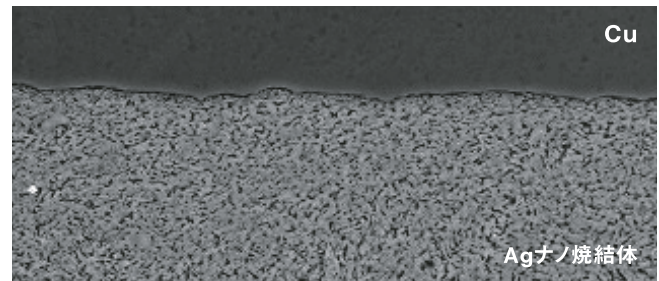
基板

製品仕様

□ 塗布形態(粉末量)による膜厚調整

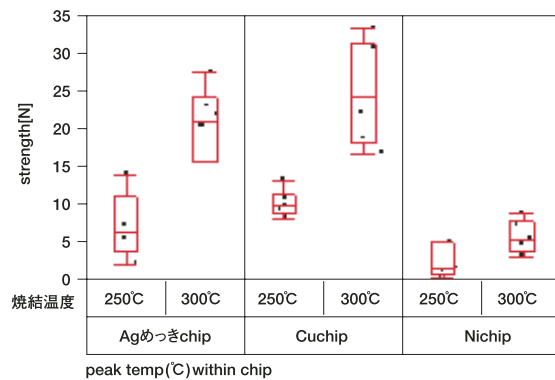


□ Agナノ焼結体の断面写真



□ 被接合体種別 接合強度評価

被接合体Ag, Cu, Niに対して接合可能



■ 試験基板
セラミック焼成基板 : Agランド3×3mm□パターン
チップ表面材質 : Ag, Cu, Ni
チップサイズ : 3×3mm□パターン

□ 薄膜焼結体 比抵抗値

焼結条件によりAgバルク並みの比抵抗値が可能

